



本社：〒160-8366
東京都新宿区西新宿 6 丁目 24 番 1 号
西新宿三井ビルディング

報告書番号：PCN#20130422001
2013 年 4 月 25 日

お客様各位

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社
営業・技術本部 カスタマドキュメント
マネージャ 牧 達郎 

EPD QFN パッケージ 一部製品 Cu(銅)ボンディングワイア変更のご案内

拝啓 貴社益々ご清栄の事とお喜び申し上げます。平素は弊社製品のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。さて、標題の件につきましてご連絡させていただきます。ご査収の程、宜しく願い申し上げます。

今回のお知らせは、変更実施についての連絡になります。変更の詳細は、次頁以降をご参照下さい。

お客様におかれましては、本通知発行日後、**30** 日以内に通知確認のご連絡をお願いいたします。また、90 日以内にご連絡が無い場合には、本変更をご承認いただけただけのものとして判断させていただきます。変更品評価用サンプルもしくは追加データご入用の場合には、本通知発行日後 30 日以内にご依頼をお願いいたします。

変更品の出荷につきましては、お客様との早期変更実施の個別契約を締結している場合を除いては、本通知発行日より **90** 日以降に予定いたしております。この通知期間は、弊社品質標準に基づいております。

本通知は、いかなる製品の製造終了に関する状況を変更するものではございません。既に製造終了の連絡をさせていただいている場合には、本通知によって、既通知の最終受注日及び最終出荷日が延長されることはございません。

本通知は、通知日前 24 ヶ月以内に本変更対象製品をご購入いただいたお客様に連絡させていただいております。

尚、変更時期につきましては、在庫状況により異なりますので、担当営業にお問い合わせ下さい。また、ご不明な点、ご質問等がございましたら、担当営業或いは pcn_tij@list.ti.com にお問い合わせ下さい。

以上

変更概要

通知タイプ	<input type="checkbox"/> Initial notice (Plan)	<input checked="" type="checkbox"/> Final notice		
変更概要	Design/Specification	<input type="checkbox"/> Design	<input type="checkbox"/> Electrical	<input type="checkbox"/> Mechanical
	Wafer Fab	<input type="checkbox"/> Site	<input type="checkbox"/> Process	<input type="checkbox"/> Material
	Wafer Bump	<input type="checkbox"/> Site	<input type="checkbox"/> Process	<input type="checkbox"/> Material
	<input checked="" type="checkbox"/> Assembly	<input type="checkbox"/> Site	<input type="checkbox"/> Process	<input checked="" type="checkbox"/> Material
	Test	<input type="checkbox"/> Site	<input type="checkbox"/> Process	
	Others	<input type="checkbox"/> Packing/Shipping/Labeling	<input type="checkbox"/> -	
変更内容	EPD QFN パッケージ 一部製品 Cu(銅)ボンディングワイア変更 現行 : Au(金)線 変更後 : Cu(銅)線			
対象製品	対象製品リスト参照			
変更時期	8月上旬の出荷より予定しています。			
品質認定試験	<input checked="" type="checkbox"/> 計画	<input type="checkbox"/> 終了		
製品表示	<input checked="" type="checkbox"/> 変更無し	<input type="checkbox"/> 変更あり		
備考	-			

変更内容

内容：弊社 EPD(エンベデッドプロセッシング) QFNパッケージ 一部製品について、現行 Au(金)線ボンディングワイアを使用して製造していますが、機械/電气的特性の向上、同種製品の組立技術推移対応及び供給能力/部材調達利便性向上の為に、これに替えて、Cu(銅)線ボンディングワイアに変更します。尚、今回の変更で、製品についての互換性(寸法/公差)、外観、動作特性、品質、信頼性への影響はありません。

変更内容	現行	変更後
ボンディングワイア	Au(金)線	Cu(銅)線
ワイヤ径	0.96 mils	0.80 mils

理由：機械/電气的特性の向上、同種製品の組立技術推移対応及び供給能力/部材調達利便性向上の為

対象製品リスト

対象製品名				
CC1101-LP-RGPR	CC115LRGPT	CC2533ARHAR	CC2540F25ARHAR	FRE006RHBT
CC1101RGP	CC2530F128RHAR	CC2533F32RHAR	CC2541F128RHAR	FRE008RHAR
CC1101RGPR	CC2530F128RHAT	CC2533F32RHAT	CC2541F128RHAT	FRE009RHAR
CC1101RGPT	CC2530F12CRHAR	CC2533F64RHAR	CC2541F256RHAR	FRE010RHAR
CC110LRGPR	CC2530F256RHAR	CC2533F64RHAT	CC2541F256RHAT	HPA00700F256RHAR
CC110LRGPT	CC2530F256RHAT	CC2533F96RHA	CC2541SRHAR	HPA00702F128RHAR
CC1110F16RHHR	CC2530F25CRHAR	CC2533F96RHAR	CC2541SRHAT	HPA00703F64RHAR
CC1110F16RHHT	CC2530F32RHAR	CC2533F96RHAT	CC2544RHB	HPA01064RHAR
CC1110F32RHHR	CC2530F32RHAT	CC2534RHAR	CC2544RHBR	HPA01215RHAR
CC1110F32RHHT	CC2530F64RHAR	CC2534RHAT	CC2544RHBT	HPA01216RHAR
CC1110F8RHHR	CC2530F64RHAT	CC2534RHAX	CC2570RHAR	HPA02146RHAR
CC1110F8RHHT	CC2531F128RHAR	CC2540F128RHAR	CC2570RHAT	TLMW301RGPR
CC113LRGPR	CC2531F128RHAT	CC2540F128RHAT	CC2571RHAR	
CC113LRGPT	CC2531F256RHAR	CC2540F256RHAR	CC2571RHAT	
CC115LRGPR	CC2531F256RHAT	CC2540F256RHAT	FRE006RHBR	

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社

信頼性試験

信頼性試験計画

信頼性試験期間	開始	2013年3月	終了	2013年6月
信頼性試験 - 試料構成詳細				
Qual Device:	CC2533RHA	-	-	
Assembly Site:	TI Clark	Package/Code/Pins:	QFN/RHA/40	
Mount Compound:	4207123	Mold Compound:	4208625	
Bond Wire:	0.8 Mil Dia., Cu	Lead frame (Finish, Base):	NiPdAu, Cu	
MSL:	JEDEC L-3/260C	-	-	
信頼性試験計画				
Reliability Test	Condition / Duration	Sample Size		
		Lot#1	Lot#2	Lot#3
ESD HBM	1000V	3	3	3
ESD CDM	250V	3	3	3
Electrical Characterization	-40/125C	30	30	30
Latch-Up	90C	6	6	6
**T/C	-55C/125C, 700Cyc	77	77	77
**T/C	-65C/150C, 700Cyc	26	26	25
**High Temp. Storage Bake	150C, 600Hrs	77	77	77
**Biased Temp. & Humidity	85C/85%RH, 600Hrs	26	26	25
**Unbiased HAST	110C/85%RH, 264Hrs	77	77	77
Operating Life Test	125C, 1000Hrs	39	39	38
Manufacturability (Assembly)	per mfg. Site specification	per spec	per spec	per spec
Note: ** Preconditioning sequence: JEDEC L-3/260C.				

信頼性試験計画

信頼性試験期間	開始	2013年3月	終了	2013年6月
信頼性試験 - 試料構成詳細				
Qual Device:	CC1101RGP	-	-	
Assembly Site:	TI Clark	Package/Code/Pins:	QFN/RGP/20	
Mount Compound:	4207123	Mold Compound:	4208625	
Bond Wire:	0.8 Mil Dia., Cu	Lead frame (Finish, Base):	NiPdAu, Cu	
MSL:	JEDEC L-3/260C	-	-	
信頼性試験計画				
Reliability Test	Condition / Duration	Sample Size		
		Lot#1	Lot#2	Lot#3
ESD HBM	1000V	3	3	3
ESD CDM	250V	3	3	3
Electrical Characterization	-40/85C	30	30	30
Latch-Up	90C	6	6	6
**T/C	-55C/125C, 500Cyc	77	77	77
**High Temp. Storage Bake	150C, 600Hrs	77	77	77
**Biased Temp. & Humidity	85C/85%RH, 600Hrs	26	26	25
**Unbiased HAST	110C/85%RH, 264Hrs	77	77	77
Manufacturability (Assembly)	per mfg. Site specification	per spec	per spec	per spec
Note: ** Preconditioning sequence: JEDEC L-3/260C.				